

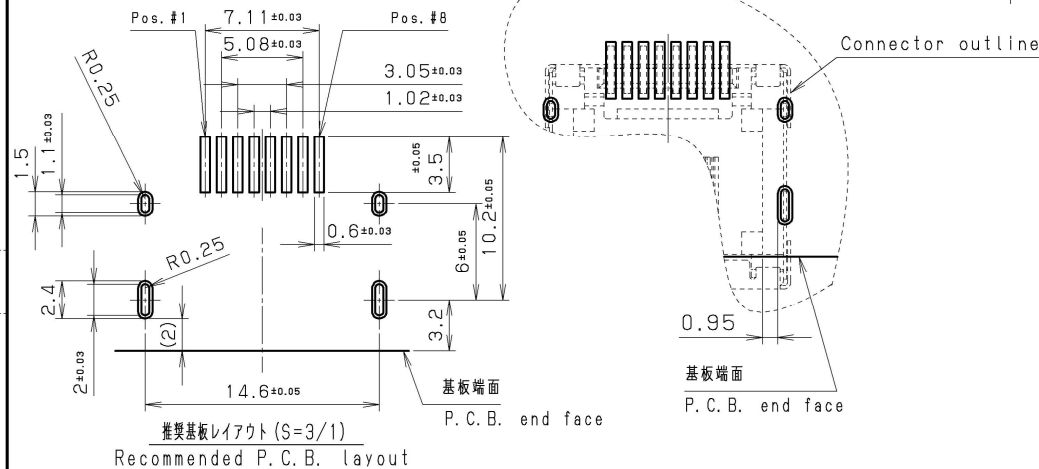
外観  
Appearance

嵌合部詳細 (S=5/1)  
Contact detail (S=5/1)

推奨パネル取付寸法 (S=5/1)  
Recommended Panel Design (S=5/1)

- 注1. コンタクト処理  
 接触部 : パラジウムニッケルめっき0.1μm以上  
 + 金めっき0.03μm以上  
 SMT部 : 金めっき0.03μm以上  
 下地 : ニッケルめっき
- 注2. コプラナリティ: 0.1mm以下
- 注3. シェル板厚 t=0.2mm
- 注4. コンタクト処理は、RJ-45の規格ではありません。  
 注5. リフロー-DIP対応品 (リフロー実装を想定)
- 注6. パネル接触ばねの接点位置は、  
 コネクタ前面より3±0.3mmにて設計しています。

- Note
- Contact plating  
 Contact area : Palladium-Nickel 0.1μm min.  
 + Gold 0.03μm min.  
 Termination area: Gold 0.03μm min.  
 Underplating : Nickel
  - Coplanarity : 0.1mm max.
  - Shell thickness : t=0.2mm
  - Contact plating is not the standard of the RJ-45.
  - This Connector is met by reflow DIP.  
 (It is possible by once.)
  - The shield contacts are designed in 3±0.3mm  
 out of connector front surface.



RoHS compliant

改版 LTR	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
					4 絶縁体B Insulator B	PA9T (GF)	1		UL94V-0 BLACK
					3 シェル Shell	りん青銅 Phosphor bronze	1		ニッケルめっき Nickel
					2 コンタクト Contact	りん青銅 Phosphor bronze	8	注1	
					1 絶縁体A Insulator A	PA9T (GF)	1		UL94V-0 BLACK
年月日 DATE	Feb. 17 (2017)	尺度 SCALE	2/1	単位 UNIT	mm (INCH)	3角法 3RD. A. P	<b>HTK</b> 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.		
製図 DR.	設計 DE.	検 CHK.	検 CHK.	承認 APP.	名称 NAME	RJ-45モジュラージャック リバースMT・パネル接地タイプ (RoHS) RJ-45 modular jack reverse SMT and panel earth type (RoHS)			
S. WATANABE	S. WATANABE	K. ODAKU		K. HOMMA	製番 PART NO.	MOD-RJ88LY1GA+ REV.			